

УДК 548.4

**МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВАЯ ЭПИТАКСИЯ  
И ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ СЛОЕВ  $\text{CaF}_2$   
И  $\text{SrF}_2$  НА  $\text{GaAs}$  (111)**

**Я. Г. Копьев, С. В. Новиков, Н. С. Соколов, Н. Л. Яковлев**

Методом молекулярно-лучевой эпитаксии выращены диэлектрические слои  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{SrF}_2$  на  $\text{GaAs}$  (111). С помощью анализа картин дифракции быстрых электронов на отражение показано, что после предростовой очистки поверхности  $\text{GaAs}$  при  $530^\circ\text{C}$  с самых начальных стадий наблюдается эпитаксиальный рост фторида. При температуре очистки  $580^\circ\text{C}$  вначале наблюдается поликристаллический рост, затем происходит упорядочение растущей поверхности и при толщине слоя около 100 нм наблюдается эпитаксия. Величины упругих деформаций, измеренных по деформационному смещению бесфононной линии  $\text{Eu}^{2+}$  перехода  $5d-4f$ , составляли  $(0.6-0.8) \cdot 10^{-2}$  в первом случае и менее  $0.2 \cdot 10^{-2}$  во втором.

Эпитаксиальные диэлектрические слои фторидов кальция и стронция на арсениде галлия представляют значительный интерес главным образом в связи с возможностями их применения при создании трехмерных интегральных схем и МДП-структур [1]. В [2] исследовался рост  $\text{CaF}_2$  и  $\text{SrF}_2$  на арсениде галлия, а в [3] — рост твердых растворов фторидов кальция и стронция на поверхностях (100) и (110) этого кристалла методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ).

Величины относительного рассогласования постоянных решетки при комнатной температуре составляют  $-3.40\%$  для  $\text{CaF}_2/\text{GaAs}$  и  $+2.56\%$  для  $\text{SrF}_2/\text{GaAs}$ . При температуре роста  $500^\circ\text{C}$  эти величины близки к  $-2.5$  и  $3.4\%$  соответственно. В связи с этим представляется интересным изучение в эпитаксиальных слоях фторидов внутренних деформаций, могущих оказывать существенное влияние на свойства границы раздела полупроводник—диэлектрик [4]. В [5, 6] для измерения упругих деформаций в эпитаксиальных слоях  $\text{CaF}_2$  на  $\text{Si}$  (111) был использован метод примесного фотолюминесцентного зонда, имеющий более высокую чувствительность, чем обратное резерфордовское рассеяние  $\text{He}^+$  при наклонном падении [7].

В настоящей работе методом МЛЭ нами были выращены диэлектрические слои  $\text{CaF}_2$  и  $\text{SrF}_2$  на  $\text{GaAs}$  (111), по картинам дифракции быстрых электронов (ДБЭ) на отражение оценено их кристаллическое качество. Путем измерения деформационного смещения бесфононной линии фотoluminesценции (ФЛ)  $\text{Eu}^{2+}$  перехода  $5d-4f$  определены величины упругих деформаций слоев фторидов кальция и стронция.

**МЛЭ фторидов кальция и стронция на  $\text{GaAs}$  (111)**

Для выращивания слоев  $\text{CaF}_2$  и  $\text{SrF}_2$  на арсениде галлия нами была использована установка, в основных чертах описанная в [5]. Подложками служили монокристаллические пластинки арсенида галлия с размерами  $6 \times 15 \times 0.35$  мм. После стандартной механической и химической обработок поверхности подложек они обезжиривались в ацетоне, затем кипятились

в деионизованной воде и обрабатывались в сернoperекисном травителе  $\text{H}_2\text{SO}_4 : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O}$  (3 : 1 : 1) и, наконец, обрабатывались в HF, что приводило к снижению скорости роста собственного окисла на поверхности арсенида галлия.

Приготовленные таким образом подложки в сосуде с водой переносились в бокс, пристыкованный к шлюзовому устройству вакуумной установки. В боксе в атмосфере сухого азота подложки с помощью индия припаивались к спутникам из молибдена и затем без контакта с атмосферным воздухом через шлюз загружались в вакуумную установку.

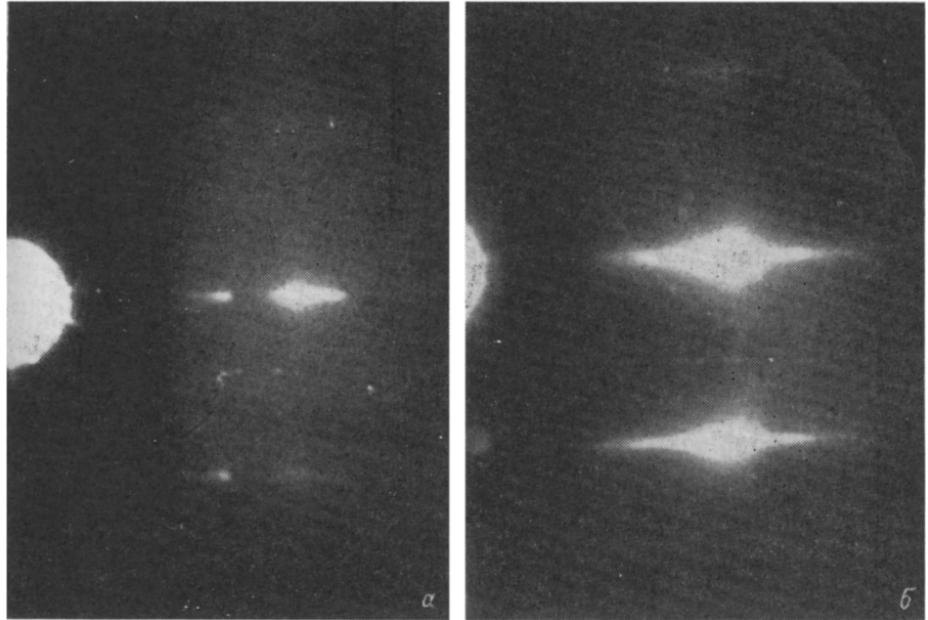


Рис. 1. Картина ДБЭ при 14 кВ и азимуте [11 $\bar{2}$ ] от поверхности (111).  
а — GaAs перед процессом эпитаксии, б — слой  $\text{CaF}_2$  толщиной 100 нм.

После предварительного прогрева до 150—200 °С производилось термическое испарение окислов в течение 20—30 мин при температурах 530 или 580 °С. При этом рефлексы арсенида галлия на картине ДБЭ удлинялись, что указывало на выглаживание кристаллической поверхности, и наблюдалось некоторое ослабление диффузионного фона. Дополнительные рефлексы, связанные с наличием сверхструктурных перестроек, не появлялись (рис. 1, а).

Выращивание слоев фторидов производилось при температуре подложек 530 °С. Использовались стороны как A, так и B пластин GaAs (111), при этом существенной разницы в процессах роста фторидов обнаружено не было. Скорость роста слоев составляла от 2 до 5 нм/мин; толщины слоев, исследованных в настоящей работе, составляли 100—130 нм.

#### Фотолюминесценция $\text{Eu}^{2+}$ и деформации слоев фторидов

Двухвалентные ионы  $\text{Eu}^{2+}$  во фторидах кальция и стронция замещают ионы металла и приводят к появлению полос поглощения в ближней ультрафиолетовой области спектра. При возбуждении активированных европием кристаллов наблюдается яркая синяя люминесценция с узкой пригелиевых температурах бесфоновой линией, имеющей длину волны  $\lambda_0 = 413.0$  нм в  $\text{CaF}_2$  и  $\lambda_0 = 401.1$  нм в  $\text{SrF}_2$  (кривые 6 на рис. 2, 4). В [6, 9] показано, что в плосконапряженном случае для поверхности (111) можно

получить связь между величиной деформации в плоскости слоя  $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy}$  и величиной энергетического сдвига бесфононной линии  $\Delta E$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{C_{11} + 2C_{12} + 4C_{44}}{2(C_{11} + 2C_{12})C_{44}} \frac{\Delta E}{6A}, \quad (1)$$

где  $C_{ij}$  — упругие постоянные кристалла;  $A$  — коэффициент, определяемый из эксперимента по деформационному смещению этой линии при одноосном сжатии [9]. Подставляя в (1) значения констант и переходя к сдвигу по длине волны  $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ , получим

$$\varepsilon_{xx} = 0.45 \cdot 10^{-2} \lambda \text{ [нм]} (\text{CaF}_2); \quad \varepsilon_{xx} = 0.35 \cdot 10^{-2} \Delta\lambda \text{ [нм]} (\text{SrF}_2). \quad (2a), (2b)$$

Для измерения спектров фотолюминесценции образцы помещались в оптический гелиевый криостат. Возбуждение ФЛ производилось азотным лазером ( $\lambda = 337$  нм), а регистрация осуществлялась с помощью решеточного монахроматора, фотоумножителя ФЭУ-79 и схемы синхронного детектирования.

### Экспериментальные результаты

После испарения окислов с поверхности арсенида галлия при  $T = 530$  °С и открывания шторки источника  $\text{CaF}_2$  через несколько секунд устанавливалась картина ДБЭ (рис. 1, б), аналогичная наблюдаемой при росте  $\text{CaF}_2/\text{Si}$  (111) [1, 5]. Такой характер картины ДБЭ сохранялся до конца

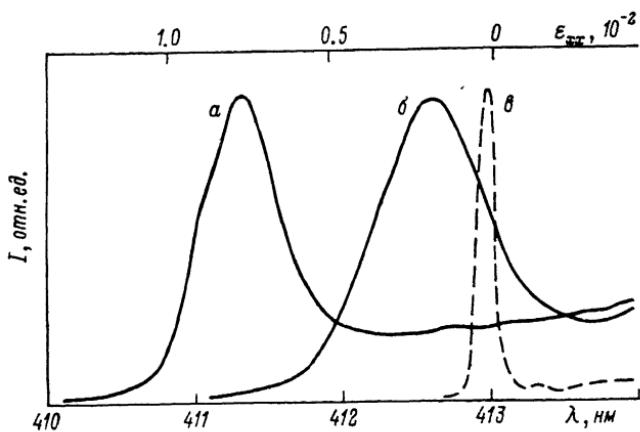


Рис. 2. Спектры фотолюминесценции слоев  $\text{CaF}_2 : \text{Eu}^{2+}/\text{GaAs}$  (111), выращенных после различных температур очистки (°C): 530 (a), 580 (b), и исходного монокристаллического  $\text{CaF}_2 : 0.05 \% \text{ Eu}^{2+}$  (c) при  $T = 1.8$  К.

На верхней шкале приведены величины плоской деформации (2a), соответствующей положениям линии  $\text{Eu}^{2+}$ .

роста и указывал на рост монокристаллического и гладкого в атомном масштабе слоя фторида. Положение бесфононной линии в спектре ФЛ таких слоев (рис. 2, кривая a) указывало на наличие достаточно однородной деформации растяжения величиной около  $0.8 \cdot 10^{-2}$ .

В том случае когда термическая очистка поверхности арсенида галлия производилась при  $T = 580$  °С, картины ДБЭ имели иной вид. На начальных стадиях роста можно было видеть только кольца поликристалла (рис. 3, a), в конце опыта наблюдался отчетливый эпитаксиальный рост  $\text{CaF}_2$  (рис. 3, б). В спектре люминесценции этого слоя (рис. 2, кривая б) наблюдалась линия, положение которой ( $\lambda = 412.6$  нм) указывает на наличие относительно малой деформации растяжения ( $0.18 \cdot 10^{-2}$ ).

При выращивании слоев  $\text{SrF}_2$  на  $\text{GaAs}$  (111) после очистки при температуре 530 °С в течение всего роста наблюдались картины ДБЭ на отражение, характерные для монокристаллических, гладких в атомном масштабе, поверхностей фторидов (аналогичные приведенным на рис. 1, б). Спектр ФЛ

одного из таких слоев представлен на рис. 4 (кривая *a*). Положение бесфононной линии в спектре (399.3 нм) в соответствии с (2б) указывает на наличие деформации растяжения  $0.6 \cdot 10^{-2}$ . На рис. 4 (кривая *b*) приведен спектр ФЛ слоя, выращенного для сравнения при температуре 150 °С, когда эпитаксия отсутствовала и в картинах ДБЭ наблюдалась только кольца поликристалла. Можно видеть, что упругие напряжения в этом случае незначительны.

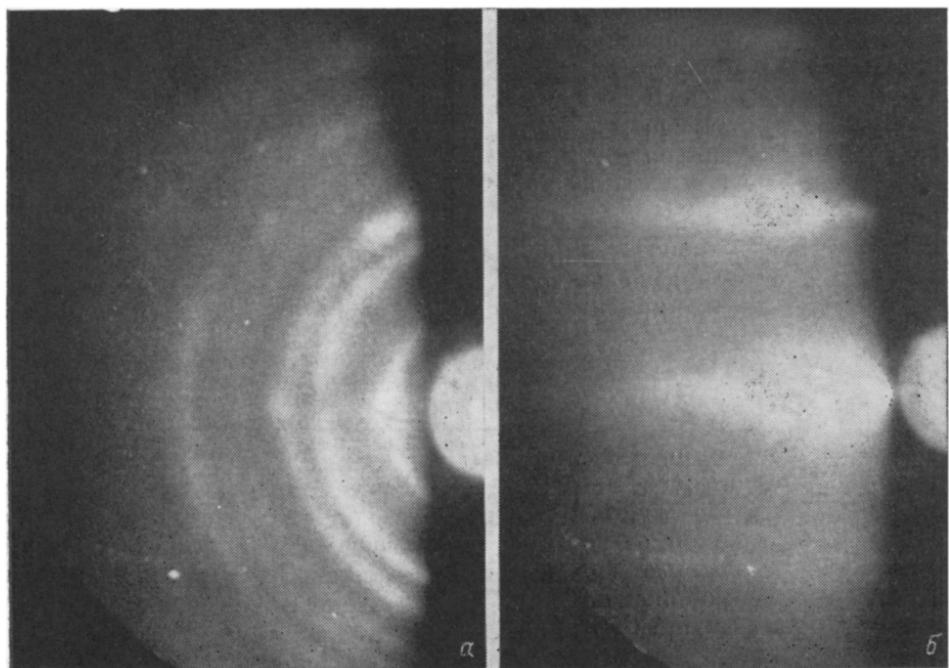


Рис. 3. Картины ДБЭ при 14 кВ и азимуте [112] от поверхности  $\text{CaF}_2/\text{GaAs}$  (111) через 2 мин после начала роста (*a*) и через 30 мин (*b*) при толщине слоя 130 нм.

### Обсуждение

В соответствии с (2) коротковолновый сдвиг бесфононной линии  $\text{Eu}^{2+}$  в слоях  $\text{CaF}_2$  и  $\text{SrF}_2$  на  $\text{GaAs}$  (111) указывает на наличие деформации растяжения в этих эпитаксиальных слоях, несмотря на то что знаки величин рассогласования постоянных решетки арсенида галлия и этих двух фторидов различны: отрицательный для  $\text{CaF}_2$  и положительный для  $\text{SrF}_2$ . В то же время коэффициенты термического расширения (КТР)  $\text{CaF}_2$  и  $\text{SrF}_2$  при  $T=300$  °С близки ( $19 \cdot 10^{-6}$  и  $18 \cdot 10^{-6}$  град $^{-1}$  соответственно) и значительно превышают КТР арсенида галлия ( $6 \cdot 10^{-6}$  град $^{-1}$ ). Все это дает основание полагать, что при росте достаточно толстых эпитаксиальных слоев фторидов кальция и стронция на поверхности (111) арсенида галлия имеет место ситуация, сходная с ростом  $\text{CaF}_2$  на  $\text{Si}$  (111) [6, 7]. В этих работах на основе результатов изучения упругих деформаций в слоях  $\text{CaF}_2$  на  $\text{Si}$  (111) был сделан вывод о том, что во время роста фторида при толщине слоя более нескольких десятков нанометров за счет образования дефектов происходит релаксация упругих напряжений, связанных с несоответствием постоянных решеток слоя и подложки, и далее растет ненапряженный при температуре роста слой фторида. При охлаждении до комнатной температуры значительная часть дефектов в слое вблизи границы с полупроводником замораживается и из-за большей величины КТР фторида по сравнению с  $\text{Si}$  слой фторида оказывается растянутым.

При термической очистке поверхности  $\text{GaAs}$  при  $T=580$  °С из-за отсутствия источника мышьяка происходило, по-видимому, нарушение стехио-

метрического состава приповерхностного слоя и загрубление поверхности [8], что и являлось причиной возникновения поликристаллической фазы фторида на начальных стадиях роста (рис. 3, а).

Положения бесфононной линии  $\text{Eu}^{2+}$  в спектрах фотолюминесценции слоев в этих двух случаях существенно различались. При температуре очистки 530 °C наблюдалась достаточно однородная деформация растяжения (более  $0.6 \cdot 10^{-2}$ ). В слоях фторидов, выращенных после очистки поверхности при более высокой температуре, величины упругих деформаций были существенно меньше (менее  $0.2 \cdot 10^{-2}$  для  $\text{CaF}_2$ ), что связано, по-ви-

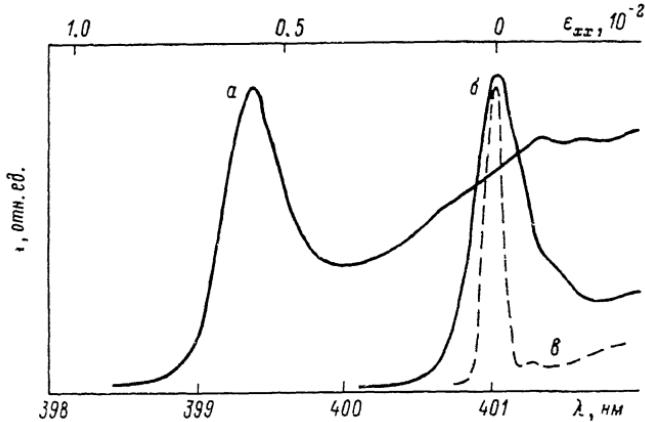


Рис. 4. Спектры фотолюминесценции слоев  $\text{SrF}_2 : \text{Eu}^{2+}/\text{GaAs}$  (111), выращенных при различных температурах подложки (°C): 530 (а), 150 (б), и исходного монокристаллического  $\text{SrF}_2$ : 0.05 %  $\text{Eu}^{2+}$  (в) при  $T=1.8$  К.

На верхней шкале приведены величины плоской деформации (26), соответствующей положениям линии  $\text{Eu}^{2+}$ .

димому, с релаксацией упругих напряжений на границах кристаллических зерен, существовавших на начальных стадиях роста таких слоев.

Таким образом, можно видеть, что кристаллическая структура слоев фторидов кальция и стронция вблизи границы с арсенидом галлия сильно зависит от температуры очистки его поверхности. При  $T=530$  °C с самых начальных стадий наблюдался эпитаксиальный рост фторидов, после очистки при  $T=580$  °C на начальных стадиях доминировал поликристаллический рост, по мере увеличения толщины слоя происходило упорядочивание его структуры, и при толщинах около 100 нм наблюдался отчетливый эпитаксиальный рост.

Это дает возможность за счет изменения режимов очистки поверхности арсенида галлия изменять величины упругих деформаций в монокристаллических диэлектрических слоях фторидов и может представлять интерес для получения как ненапряженных, так и напряженных слоев.

Авторы выражают признательность А. А. Каплянскому за поддержку работы.

#### Список литературы

- [1] Schowalter L. J., Fathauer R. W. // J. Vac. Sci. Technol. 1986. V. A4. N 3. P. 1026–1032; Величко А. А., Ноак С. К. // Обзоры по электронной технике. Сер. 3. Микроэлектроника. 1988. В. 7 (1397). 47 с.
- [2] Sullivan P. W., Bower J. E., Metze G. M. // J. Vac. Sci. Technol. 1985. V. B3. N 2. P. 500–507.
- [3] Siskos S., Fontaine C., Munoz-Yague A. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. N 6. P. 1642–1646.
- [4] Тхорик Ю. А., Хазан Л. С. Пластическая деформация и дислокации несоответствия в гетероэпитаксиальных системах. Киев: Наукова думка, 1983. 304 с.
- [5] Гастев С. В., Новиков С. В., Соколов Н. С., Яковлев Н. Л. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 13. № 16. С. 961–966.
- [6] Соколов Н. С., Вихиль Е., Гастев С. В., Новиков С. В., Яковлев Н. Л. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 2. С. 75–79.

- [7] Hashimoto S., Peng J.-L., Gibson W. M., Schowalter L. J., Fathauer R. W. // Appl. Phys. Lett. 1985. V. 47. N 10. P. 1071—1073.  
[8] Elcess K., Lievin J. L., Fonstad C. G. // J. Vac. Sci. Technol. 1988. V. B6. N 2. P. 638—641.  
[9] Каплянский А. А., Пржевуский А. К. // Опт. и спектр. 1965. Т. 19. № 4. С. 597—610.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
15 июня 1989 г.

---